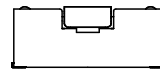
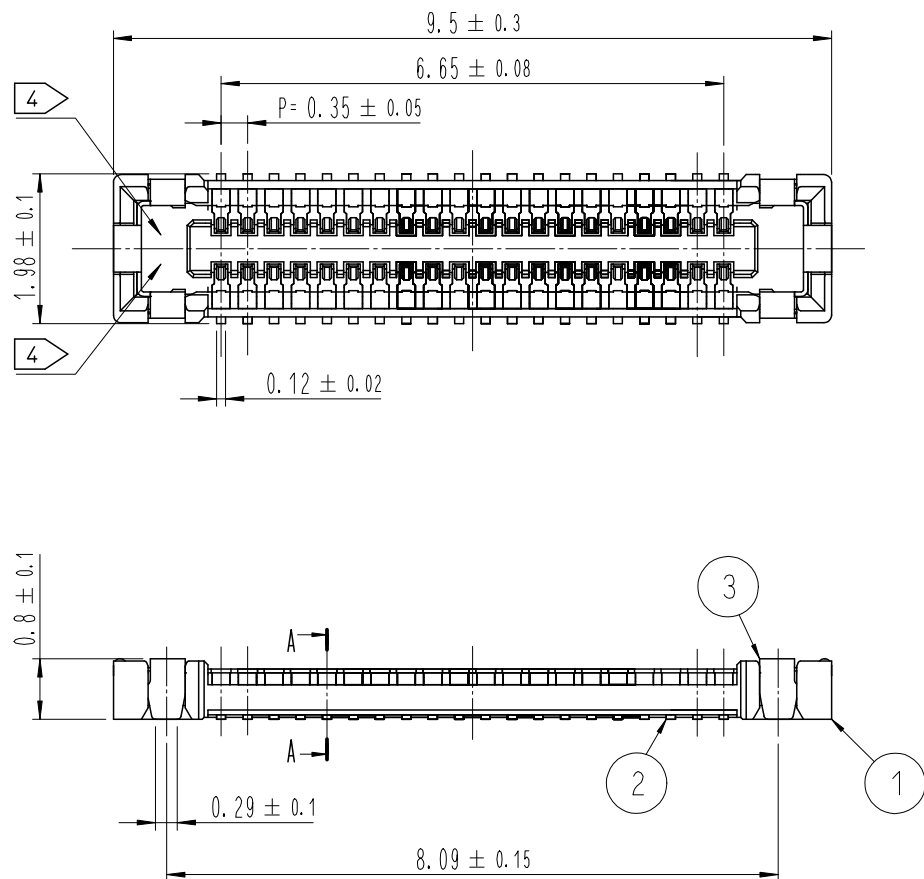


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

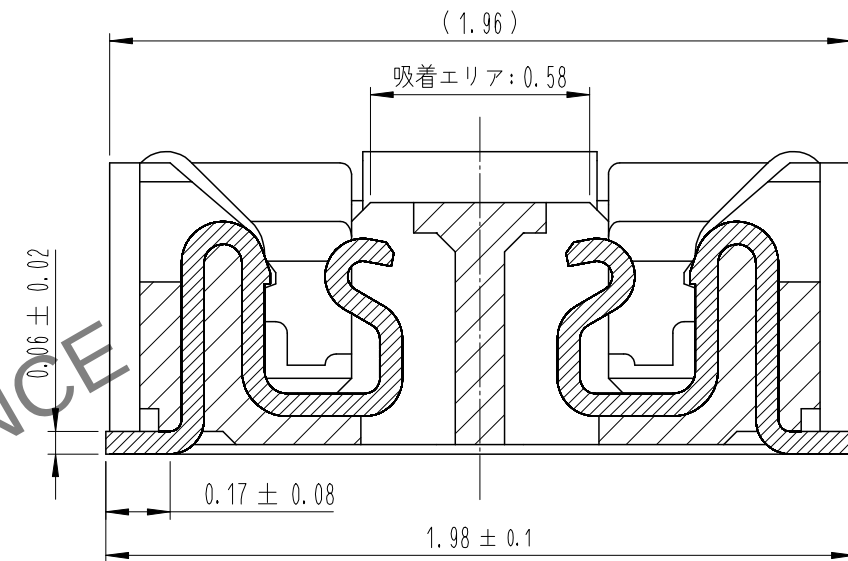
A
B
C
D
E
F



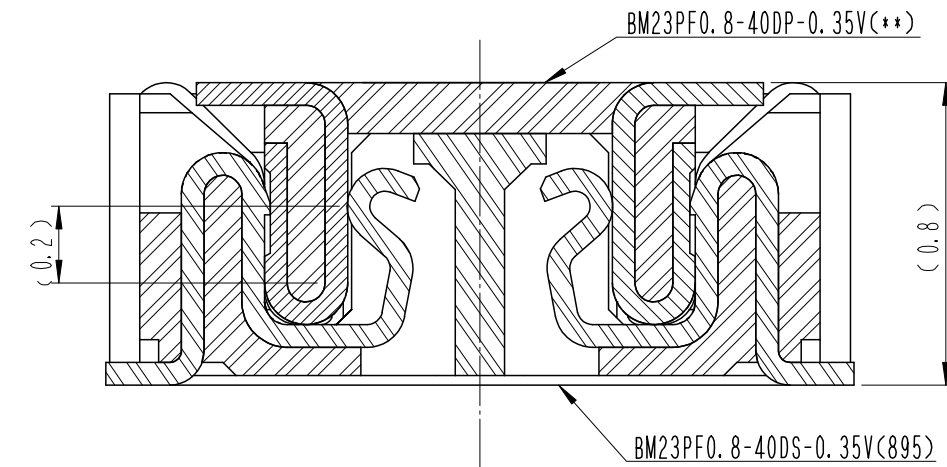
- 注 1 . 平坦度は 0.08mm 以下となります。
- 2 端子めっき仕様
接触部 : 金めっき $0.05\mu\text{m}$ MIN.
実装部 : 金めっき $0.05\mu\text{m}$ MIN.
下地 : ニッケルめっき $1\mu\text{m}$ MIN.
(表面 : 封孔処理)
- 3 補強金具めっき仕様
接触部 : 金めっき $0.05\mu\text{m}$ MIN.
下地 : ニッケルめっき $1\mu\text{m}$ MIN.
(表面 : 封孔処理)
- 4 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE
△						..	△						..
△						..	△						..
△						..	△						..

A-A (50:1)

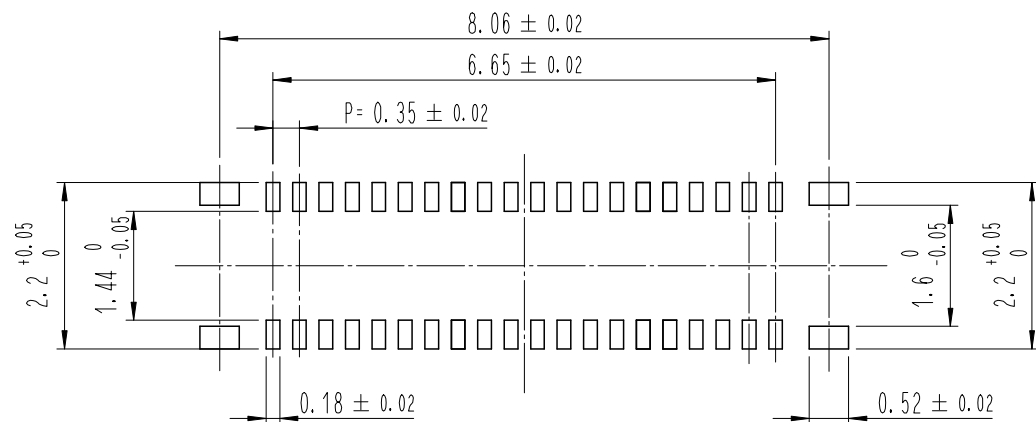


嵌合断面図 (50:1)



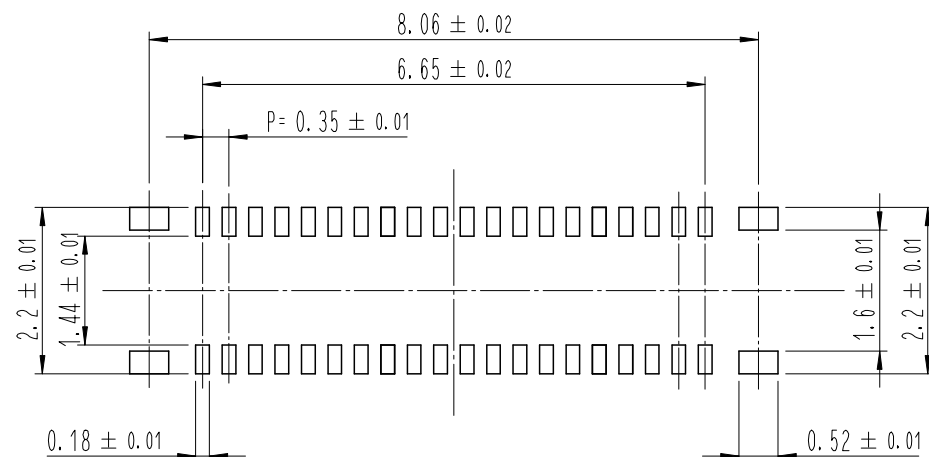
4	PS	CLEAR, エンボスカバーテープ	7	PS	CLEAR, 補強用カラー
3	銅合金	3	6	PS	BLACK, プラスチックリール
2	銅合金	2	5	POLYESTER	CLEAR, カバーテープ
1	LCP	UL94 V-0, BLACK			
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
REMARKS			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			S. H. JUNG	S. H. JUNG	H. W. JO
			17. 05. 15	17. 05. 15	17. 05. 15
			APPROVED	RELEASED	
			T. S. KANG	17. 05. 15	
CODE NO. (OLD)	SCALE	DRAWING NO.	PART NO.		
	10:1	JDC3-631971	BM23PF0.8-40DS-0.35V(895)		
	UNITS	HRS HIROSE KOREA CO., LTD.	CODE NO	CL 6644-0047-8-895	1/3
	mm				

6> ◆推奨基板パターン図

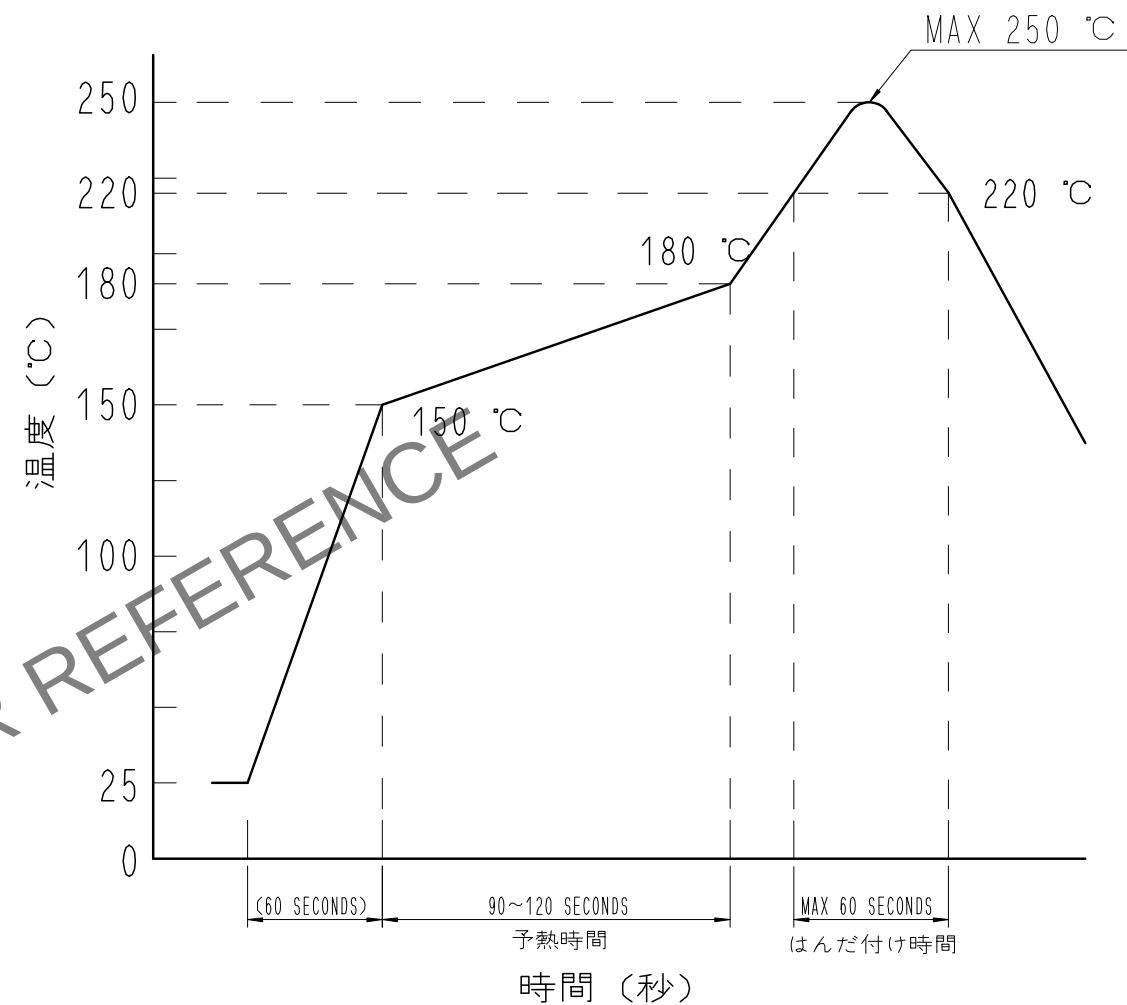


◆推奨メタルマスク開口部図

メタルマスク厚 : $100 \mu\text{m}$



5> 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル (推奨)



リフロー方式 : N_2 リフロー

リフロー回数 : 2回以下

1) 本加熱

220°C以上 60秒以下 (ピーク温度250°C)

2) 予備加熱

150~180°C 90~120秒

- 5> 温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
この温度プロファイルは上記適用条件のものです。
クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装
部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態
を十分ご確認の上ご使用願います。
- 6> 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。

	DRAWING NO.	JDC3-631971	PART NO.	BM23PF0.8-40DS-0.35V(895)
	SCALE	10:1	CODE NO	CL 6644-0047-8-895
	UNITS	mm		2/3

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

